PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-026817

(43) Date of publication of application: 29.01.1999

(51)Int.Cl.

H01L 33/00

(21)Application number : 09-182706

(71)Applicant:

KOITO IND LTD

(22)Date of filing:

08.07.1997

(72)Inventor:

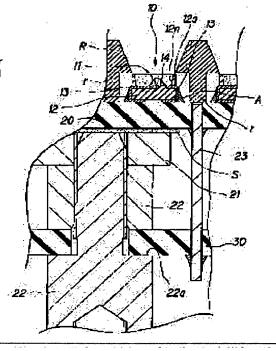
KONO TOYOHIDE TAKAHASHI TOSHIAKI

(54) LED MODULE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an LED module which can be mounted onto an LED board simply and replaceably and which exhibits high visibility.

SOLUTION: An LED module 10 comprises an LED 11, an LED fixing member 12, and an electrode 13 to which a terminal of the LED 11 is connected and which is connected to a wire on an LED board. The module 10 can be mounted on the LED board replaceably. A louver portion 12a is formed on the member 12. The portion 12a extends higher above a light-emitting portion 14 of the LED 11 while enclosing the LED 11 that has been mounted. The electrode 13 is formed in such a manner as to clamp the member 12.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

€ 翐 4 盐 华 噩 4 (E)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-26817

(43)公開日 平成11年(1999) 1月29日

FI	H01L 33/00
裁別記号	
(51) Int CL*	H01L 33/00

警査請求 未譲収 請求項の数3 ○L (全5 頁)

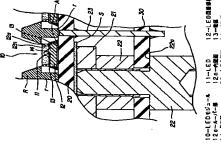
	· <	-		
390010054	47米工業存化五代 神奈川県樹茂市戸緑区黄田町100番地 阿野 豊秀 神奈川県樹茂市戸緑区前田町100番地 小	冬工業株式会社内 ▲高▼循 利明 神奈川県街阪市戸韓区前田町100番地 小	<u> </u>	
790010066	(72) 発明者	(72) 発明者	(74)代理人	
侍収平 9-182706	平成9年(1997)7月8日			
(21)出版番号	(22) 出版日			

(54) [発明の名称] LEDモジュール

(57) [聚粒]

【課題】LED基板上への実装が簡易且つ交換可能に行 え、更に、視路性の良いLEDモジュールを提供するこ

ED固着部材12には、取り付けられたLED11を囲 機してLED11の発光部14より上方に伸びるルーパ 【解決手段】 LED11と、LED固着部材12と、L ED11の端子が接続され、LED基板の配線に接続さ れる電極13とを有して、LED基板上に交換可能に実 装することのできるLEDモジュール10であって、L 一郎12aを形成し、電極13はLED固着部材12に 挟着するよう形成した。



z

とを有して、配線基板上に交換可能に実装することので 【精水填2】LEDと、LED固着部材と、前記LED の端子が接続され、LED基板の配線に接続される電極 れたことを特徴とするLEDモジュール。 きるしEDモジュールであって、 前記しED固着部材は、取り付けられた前記しEDを囲 と、前記覚極の一部を装着するための電極装着部とが形 続して抜し EDの発光部より 上方に伸びてその内壁面側 が上方へ向かって拡がるように形成されたルーパー部

前記句権は、前記電極装着部と前記しED固着部材の底 面倒とを挟んで取り付けるよう形成したことを特徴とす るしEDモジュール。

【請求項3】前記配極は、複数個の前記各LEDの一方 の同種の端子と個別に接続された個別電極と、前記各L EDの他方の同種の端子が接続された共通配権とである ことを特徴とする請求項1または2に記載のLEDモジ

[発明の詳細な説明]

【発明の属する技術分野】本発明は、LEDと、核LE Dを固着するためのLED固着部材と、前記LEDに接 続された電極とを有して、LED基板上に交換可能に実 抜することのできるLEDモジュールに関する。 [0001]

[0002]

して取り付けたものである。また、降り合うしED4の [0003] すなわち、一枚のLED基板2にレンズ3 の付いた多数のLED4を個々にワイヤーボンディング 【従来の技術】従来この種のLEDモジュールとして は、例えば、図りに示すようなものがある。

[0004]

光部6が散けられている。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ

間には、グレアによる視路性の低下を防止するために遮

イヤーボンディングされているために故障の生じたもの うな従来のLEDモジュール1では、多数のLED4の 中に故障の発生したものがあっても、LED基板2にワ だけを交換するということが難しかった。さらに、遮光 **部6がLED4の個別の交換をより一局難しくしてい**

20 【0005】また、遮光部6を散けていない場合にはコ

特阻平11-26817

8

ントラストが悪く視器性が良くないという問題点があっ、

[0006] 本発明は、このような従来の問題点に着目 且つ、交換可能なLEDモジュールを提供することを目 してなされたもので、LED基板上への実装が簡易で、

の端子が接続され、LED基板の配線に接続される電極 とを有して、LED基板上に交換可能に実装することの 前記しED固着部材は、取り付けられた前記しEDを囲 **換して抜しEDの発光部より上方に伸びるルーパー部が**

できるLEDモジュールであって、

【讃求項1】LEDと、LED固着部材と、前記LED

[特許語状の範囲]

【0007】さらに、本発明はコントラストが良く、良 好な視路性を発揮するLEDモジュールを提供すること を目的としている。 的としている。

[0008]

9

前記電極は、前記LED固着部材に挟着するよう形成さ

形成され、

【課題を解決するための手段】かかる目的を遠成するた めの要旨とするところは、次の各項に存する。 【0009】 [1] LED (11) と、LED固治部材 (12) と、前部LED (11)の稿子が敬頼され、L LED基板上に交換可能に実数することのできるLED モジュール (10) であって、前記LED固着部材 (1 2) は、取り付けられた前記LED (11) を囲<mark>換して</mark> **数LED(11)の発光部(14)より上方に伸びるル** 前記しED固労部材 (12) に挟着するよう形成したこ ーバー語 (12a) が形成され、拒配的語 (13) は、 ED基板の配線に接続される電極(13)とを有して、 とを特徴とするLEDモジュール(10)。 20

LED基板上に交換可能に実装することのできるLED 2) は、取り付けられた前配LED(11)を囲<mark>換して</mark> 成されたルーパー部 (12a) と、前記電極 (13)の [0010] [2] LED (11) と、LED固君部材 (12) と、前配LED (11)の増子が接続され、L モジュール (10) であって、前配LED固労部材 (1 **数LED(11)の発光部(14)より上方に伸びてそ** の内壁面 (12n) 倒が上方へ向かって甘がるように形 れ、前記電極(13)は、前記電極装着部(15)と前 記LED固若部材 (12)の底面側とを挟んで取り付け るよう形成したことを特徴とするLEDモジュール(1 ED基板の配線に接続される饥極(13)とを有して、 一部を装着するための低極装着部(15)とが形成さ

30

【0011】 [3] 前記電極 (13) は、複数個の前記 各LED(11)の一方の同種の端子と個別に接続され **た個別配極 (13A、13B、13C) と、前配各し**E D (11) の他方の同種の端子が接続された共通配権 4

(13D) とであることを特徴とする [1] または [2] 記載のLEDモジュール (10)。

【0013】上記LEDモジュール (10) は、その前 記電極 (13) をしED基板上の所望のしED上に載せ る。このようにして前記しEDモジュール (10) を多 数しED基板上に散けることにより容易にLED表示板 た状態ではんだ箏を用いて容易に取り付けることができ [0012] 次に作用を説明する。

【0014】 煎恕LEDモジュール (10) には発光部 **等を製造することができる。**

ල

€

【0015】 哲記しEDモジュール(10)は、単体で 前記しED基板上から取り外しができるので、前記LE D (11) に故障が発生したときは、その故障したしE D(11)が取り付けられているしEDモジュール(1 と交換することができる。従って、前配LEDモジュー ル(10)を用いたLED表示板等は、メンテナンスに 0) のみを取り外し、新しいLEDモジュール (10) 優れ、常に最善の表示状態を提供することができる。 【発明の実施の形態】以下、図面に基づき本発明の一実 施の形態を説明する。

[0016]

【0017】図1か5図6は本発明の一の実施の形態を 示している。

はLED11と、LED固着部材12と、LED11の 【0018】図1に示すように、LEDモジュール10 **端子が接続され、LED基板20の配線に接続される電** 極13とを有している。

【0019】 LEDモジュール10は多数個を例えば図 5に示したように設けて各種の情報を表示する表示板等 が作られる。 [0020] 図1はLEDモジュール10が取り付けら れる周辺の部材を示すためにLEDモジュール10には 1つのLED11のみを示して簡略してある。図2と図 3には3つのLED11を取り付けたフルカラータイプ のLEDモジュール10を示してある。

2は例えば変性ポリアミド等の成形が容易で且つ絶縁性 [0021] LEDモジュール10のLED固着部材1 を有する案材で作られている。 【0022】LED固着部材12は、取り付けられた3 つのLED11を囲**換**してLED11の発光部14より 【0023】ルーパー第12aの内壁面12n側は上方 へ向かって内径が連続的に拡大するように形成されてい 5。ルーパー部12aより下方には、薄板状の導体で作 上方に伸びるルーパー部12aが形成されている。

られた電極13の一部を挿入可能な電極装着部15が形

通電極13Dの何れも、電極装着部15としED固着部 【0024】図3(A)乃至(D)に示したように、L ED固着部材12はルーパー部12aの内壁面12n内 側の上面が略平坦に形成されており、3つのLED11 111B、11Cはそれぞれアノードが個別に3つの個別 [0025] 個別電極13A、13B、13Cおよび共 **配極13A、13B、13Cに接続されており、カソー** A、11B、11Cが散けられている。LED11A、 ドは共通する1つの共通電極13Dに接続されている。

材12の底面側とを挟むようにして取り付けるように形

【0026】また、LED固ᅒ部材12はルーパー部1 2 a の内側には例えば遜明なエポキシレジンのようなポ ッティング液が微ちた状態で固化している。 【0027】図4はLEDモジュール10における、各 色の発光が可能なLEDであり、LED11BはGaN 半導体からなる骨色の発光が可能なLEDであり、LE D11CはGaAsP半導体からなる赤色の発光が可能 なしEDである。各しEDのアノードは上記したように LED11A、11B、11Cの接続関係を示す接続図 である。例えばLED11AはGaP半導体からなる縁 カソードは図からも用らかなように一つの共通電極13 それぞれ個別電極13A、13B、13Cに接続され、 Dに接続されている。 10

【0028】LED基板20の上面にはLEDモジュー ル10の設けられている側に前記の各電極と接続され各 LEDのアノードとカソードとの間に通償するための配 は、はんだAによってその電極13の部分がLED基板 20の配線上に接続されている。さらに、LEDモジュ ール10を囲むように形成されたリフレクターRが散け る。すなわち、LEDモジュール10の最上部と同じ高 れ、LEDモジュール10直近上方でLEDモジュール 10に向かってオーベーハングし、オーバーハングの先 **絡部から上に向かって広がるような形状に形成されてい** る。オーバーハングはLEDモジュール10からの発射 バー部12aの内壁面12nに先端部がかからないよう に形成されている。また、色は視器性を良くするために 通常は黒色である。しED基板20の下面には絶縁体の シリコンラパーSが貼着されている。さらにシリコンラ 光を遮らないように最大でもLED固着部材12のルー LED基板20の下方には間隔を散けてLEDモジュー られている。リフレクターRの断面形状は矢印を立て、 パーSの一部と接触して放熱板21が配散されている。 級パターンが形成されている。LEDモジュール10 その先端部を切り落としたような形状に形成されてい さまではリフレクターRの足r、rの間隔が広く取ら ル10を制御するための回路基板30が散けられてい る。回路基板30の下面には種種の回路部品(図示せ ず)が取り付けられている。 20 30 9

【0029】LED基板20と回路基板30との開隔は は、一方がシリコンラパーSと当接し、他方が回路基板 が形成されているものと、放熱板21と回路基板30と の間に嵌め込むように取り付けるものとが散けられてい 30を寅通して回路基板30の下面を支える肩部22a スペーサ22によって確保されている。 スペーサ22

の間には、LED基板20上の配線と回路基板30の回 [0030] さらに、LED基板20と回路基板30と 路とを電気的に接続するためのコネクタ部材23が取り

10 所望の配線に接触するようにLEDモジュール10を載 3B、13Cと接続し、カソードを共通電極13Dに接 続する。各電極13A、13B、13C、13Dは予め 【0032】上記しEDモジュール10は、LED閻着 **部材12に3つのLED11A、11B、11Cを散け** るが、各LEDのアノードを単独に個別**位極**13A、1 LED固着部材12に挟着しておく。各電極13A、1 3B、13C、13DがLED基板20上に形成された [0031] 次に作用を説明する。

[0034] 回路基板30からの制御配流はコネクタ部 る回路基板30と接続されたLED基板20上に散ける 【0033】このようにして多数のLEDモジュール1 0を図5および図6に示したようにLED11を制御す **材23を通ってLED基板20に形成された配線パター** ことにより容易にLED表示板等を作ることができる。 せ、はんだAを用いて取り付ける。

LEDモジュール10の発光部14より上方に伸びるよ **うに形成されたルーパー部12aによって、光の進行方** ュール10から発射された光は無駄な散乱が防止される ED基板20上に散けられたリフレクターRによって光 の進行方向が規制される。このようにして各LEDモジ ので、近傍のLEDモジュール10から発射された光と [0035] 制御電流によってLED11が発光すると 向が規制される。ルーパー部12aを出た光りは更にし 干渉する度合いが低く、従ってコントラストが良好で、 憂れた視路性を得ることができる。

によってLED基板20に取り付けられているのでLE D11A、11B、11Cに故障が発生したときは、故 **障したLEDを有するLEDモジュール10のみを単体** [0036]また、LEDモジュール10は、はんだA でLED基板20上から取り外し、代わりに新しいLE で、このようなLEDモジュール10を用いたLED投 **示板等は、メンテナンスに優れ、常に最善の表示状態を** ロモジュール10を取り付けることが容易にできるの 44することができる。

なく、LEDをルーパー部を有するユニット化したLE [0037] 本形態では、LEDの端子をLED基板に 形成された配線パターンに直接にボンディングすること

Dモジュールに取付け、LEDモジュールに散けた電極 **【0038】それにより、LEDを使用する扱示手段等** の視器性を向上させることができ、また、メンテナンス を配線パターンに依続するようにしたものである。

【0039】前配形態においては、フルカラー用のLE Dモジュールとして、3種のLEDを取り付けたものを 例示したが、取り付けるLEDの種類や数は前配のもの の面でも向上させることができる。 に限定されることはない。 ば、LED表示板等の視器性の向上と、メンテナンスの 向上を同時に実現することができる。

【発明の効果】本発明にかかるLEDモジュールによれ

[0040]

【図1】本発明の一形態にかかるLEDモジュールを実 抜したLED 表示板の断面の一部を示す部分断面図であ |図面の簡単な説明|

【図2】本発用の一形態にかかるLEDモジュールの断 面図である。

ンを流れる。

【図3】(A)は本発明の一形態にかかるLEDモジュ ールの平面図であり、(B) は左側面図であり、(C) は右側面図であり、(D)は低面図である。 20

【図4】本発明の一形値にかかるLEDモジュールにお する、各LEDの接続関係を示す接続図である。

【図5】本発明の一形態にかかるLEDモジュールを多 数取り付けてなる表示板を例示する正面図である。

【図7】従来のLEDモジュールを示す略示図である。 [図6] 図5に例示した数示板の底面図である。

[符号の説明]

10…LEDモジュール 11 ... LED 30

2…LED固着部材

2 n …内壁面

13A…個別電極

3 D…共通電極

15…電極装着部

\$

[9図]

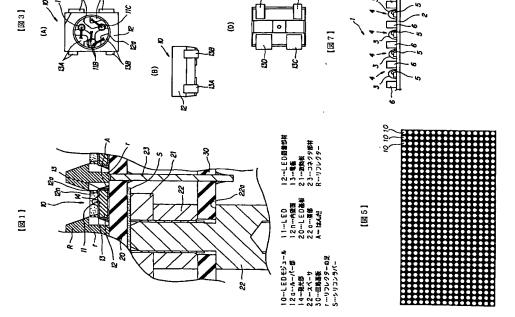
[図4]

[図]

1

-3-

20



-5-